2027年３月期　第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年11月10日

上場会社名　　シンデン・ハイテックス株式会社　　上場取引所　東
コード番号　　3131　　ＵＲＬ　https://www.shinden.co.jp/
代表者　　（役職名）代表取締役社長　　（氏名）鈴木　淳
問合せ先責任者　（役職名）常務取締役　　（氏名）田村　祥　　ＴＥＬ　03-3537-0101

半期報告書提出予定日　　2026年11月10日　　配当支払開始予定日　－
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無　　：無

（百万円未満切捨て）

１．2027年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2026年４月１日～2026年９月30日）

（１）連結経営成績（累計）　　（%表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年３月期中間期	45,832	130.4	3,766	786.1	3,551	－	2,435	－
2026年３月期中間期	19,892	△7.8	425	△39.3	254	△39.8	172	△40.8

（注）包括利益　　2027年３月期中間期　　2,356百万円　（－%）　　2026年３月期中間期　　144百万円　（△58.6%）

	１株当たり中間純利益	潜在株式調整後１株当たり中間純利益
	円 銭	円 銭
2027年３月期中間期	1,291.97	－
2026年３月期中間期	91.53	－

（注）１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２.2027年３月期中間期の経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益及び包括利益の対前年中間期増減率は1,000%を超えるため「－」を記載しております。

（２）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	１株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2027年３月期中間期	44,126	9,698	22.0	5,145.12
2026年３月期	22,134	7,467	33.7	3,961.12

（参考）自己資本　　2027年３月期中間期　　9,698百万円　　2026年３月期　　7,467百万円

２．配当の状況

	年間配当金				
	第１四半期末	第２四半期末	第３四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年３月期	－	0.00	－	130.00	130.00
2027年３月期	－	0.00			
2027年３月期（予想）			－	425.00	425.00

（注）１.直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有
２.配当予想の修正については、本日（2026年11月10日）公表いたしました「通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

３．2027年３月期の連結業績予想（2026年４月１日～2027年３月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		１株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	93,000	117.2	6,500	509.5	5,700	988.1	4,000	－	2,122.12

（注）１.直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有
２.連結業績予想の修正については、本日（2026年11月10日）公表いたしました「通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
３.2027年３月期の連結業績予想の親会社株主に帰属する当期純利益の対前期増減率は1,000%を超えるため「－」を記載しております。

※　注記事項

（１）当中間期における連結範囲の重要な変更：無

（２）中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①　会計基準等の改正に伴う会計方針の変更　：無
②　①以外の会計方針の変更　：無
③　会計上の見積りの変更　：無
④　修正再表示　：無

（４）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む）	2027年３月期中間期	2,110,200株	2026年３月期	2,110,200株
②　期末自己株式数	2027年３月期中間期	225,281株	2026年３月期	225,081株
③　期中平均株式数（中間期）	2027年３月期中間期	1,884,919株	2026年３月期中間期	1,885,139株

※　第２四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．経営成績等の概況（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 …… 2
（１）当中間期の経営成績の概況…… 2
（２）当中間期の財政状態の概況…… 3
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …… 3
２．中間連結財務諸表及び主な注記 …… 4
（１）中間連結貸借対照表 …… 4
（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 …… 5
中間連結損益計算書 …… 5
中間連結包括利益計算書 …… 6
（３）中間連結財務諸表に関する注記事項 …… 7
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 7
（継続企業の前提に関する注記） …… 7

１．経営成績等の概況

（１）当中間期の経営成績の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善を背景に個人消費に持ち直しの動きがみられるとともに、企業収益の改善や人手不足への対応、省力化・デジタル化投資の進展等を背景として設備投資が堅調に推移いたしました。また、生産や輸出についても持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調を維持いたしました。一方で、物価上昇の継続に加え、中東情勢や自然災害の影響、金融資本市場の変動等による景気下振れリスクが存在しており、先行きについては依然として不透明な状況が続いております。

当社グループが属するエレクトロニクス業界においては、生成ＡＩの普及を背景としたデータセンター等への投資拡大や、半導体市況の回復が継続しており、ＡＩ関連需要の拡大が情報インフラや産業機器など幅広い領域へ波及しております。特にメモリー関連市場では、需給のひっ迫を背景とした価格上昇が継続しており、関連商材を取り扱う企業の業績に追い風となる状況が続きました。ただし、市場環境の改善は全ての用途分野で一様ではなく、ＡＩ関連需要の取り込み状況や事業領域、ビジネスモデルの違いにより、企業間の業績差が顕在化しております。

このような情勢の下、当社グループは、半導体市況の影響を一定程度受ける事業構造を踏まえつつ、各分野における新規ビジネスの拡大や付加価値領域の強化に取り組んでおります。今後も、中期経営計画に基づき、市況変動への対応力を高めるとともに、持続的成長と資本効率の向上の両立を図ってまいります。

当中間連結会計期間における販売面は、ディスプレイ分野及びバッテリー＆電力機器分野は前年同期を下回ったものの、半導体製品分野において、メモリー関連商材の市場環境の改善に加え、新規ビジネスの拡大及び顧客需要の取り込みが進んだこと、また、システム製品分野も伸長したことから、売上高は大幅に増加しました。利益面では、半導体製品分野を中心とした販売拡大により、売上総利益が大幅に増加しました。販売費及び一般管理費は、事業規模の拡大に伴う貸倒引当金繰入額の増加等により増加したものの、売上総利益の増加がこれを上回ったことから、営業利益は増加しました。これに加え、営業外損益では、仕入資金需要の拡大に伴う支払利息の増加があった一方、為替差損益が前年同期の差損から差益に転じ、経常利益は増加しました。

その結果、売上高は458億32百万円（前年同期比130.4％増）、営業利益は37億66百万円（前年同期比786.1％増）、経常利益は35億51百万円（前年同期は２億54百万円、14.0倍）、親会社株主に帰属する中間純利益は24億35百万円（前年同期は１億72百万円、14.1倍）となりました。

品目別売上高は、次のとおりであります。

品目別	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）		当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）		増減率 （％）
	金額（千円）	構成比（％）	金額（千円）	構成比（％）	
半導体製品	12,104,591	60.9	38,275,424	83.5	216.2
ディスプレイ	3,722,337	18.7	3,481,584	7.6	△6.5
システム製品	3,224,578	16.2	3,506,274	7.7	8.7
バッテリー＆電力機器	712,007	3.6	330,390	0.7	△53.6
その他	128,557	0.6	238,673	0.5	85.7
合計	19,892,072	100.0	45,832,347	100.0	130.4

（注）当社グループの事業は、半導体製品等の電子部品や電子機器の販売という単一事業であるため、品目別の売上高を記載しております。

・半導体製品分野

メモリー関連商材の価格上昇を背景とした市場環境の改善に加え、新規ビジネスの拡大及び顧客需要の取り込みが進んだことから、大幅な増収となりました。また、調達機能を活用した製品確保や新規案件の獲得も寄与しており、メモリー関連商材を中心に、当中間連結会計期間における当社グループの業績を牽引しました。

・ディスプレイ分野

ＰＣ関連需要が一巡した影響により、液晶モジュールビジネスを中心に販売が減少したことから、減収となりました。一方、一部の液晶モジュール及び有機ＥＬ関連案件は堅調に推移しております。

・システム製品分野

検査等装置、ＡＩサーバー関連機器、Ｂｏａｒｄ製品及び通信モジュール等が伸長したことから、増収となりました。当分野は、多様な商材・ビジネスで構成されており、案件ごとの進捗や計上時期によって業績が変動する特性がありますが、各領域において継続的な案件獲得に取り組んでおります。

・バッテリー＆電力機器分野

主力であった家庭用ＥＳＳ（Energy Storage System：電力貯蔵システム）向けリチウムイオン電池ビジネスが終息局面にあることから、減収となりました。一方、その他の電池関連及び電力機器関連ビジネスにおける案件の開拓を進めており、終息事業の減少を新規案件で補完するため、当分野における販売構成の転換に取り組んでおります。

・その他分野

省エネルギーや環境負荷低減に資する商材等の販売が好調に推移したことから、増収となりました。当社グループでは、環境関連分野を含む新たな事業機会の開拓にも継続して取り組んでおります。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

（日本）

当中間連結会計期間は、半導体製品分野及びシステム製品分野の販売が伸長したことから、売上高は445億51百万円（前年同期比134.1%増）となりました。利益面につきましても、販売拡大に伴い売上総利益が増加したことから、セグメント利益は36億99百万円（前年同期比714.5%増）となりました。

（海外）

当中間連結会計期間は、半導体製品分野の販売が伸長したことから、売上高は12億81百万円（前年同期比48.5%増）となりました。損益面につきましても、販売拡大に伴い売上総利益が増加したことから、セグメント利益は42百万円（前年同期は17百万円のセグメント損失）となり、黒字転換しました。

（２）当中間期の財政状態の概況

① 資産

総資産は441億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ219億91百万円（99.4%）増加しました。主な要因は、売掛金が110億68百万円（132.6%）、商品が49億29百万円（98.9%）、前渡金が42億２百万円（324.6%）増加したことによるものであります。

② 負債

負債は344億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ197億60百万円（134.7%）増加しました。主な要因は、有利子負債が110億23百万円（95.3%）、買掛金が51億15百万円（193.3%）、前受金が22億86百万円増加したことによるものであります。

③ 純資産

純資産は96億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億30百万円（29.9%）増加しました。主な要因は、利益剰余金が23億10百万円（46.0%）増加したことによるものであります。

④ 経営指標

流動比率は、買掛金、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ25.5ポイント減少し127.4%となりました。自己資本比率は、買掛金、有利子負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ11.7ポイント減少し22.0%となりました。有利子負債対純資産比率は2.3倍となり、前連結会計年度末と比べ0.8ポイント増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社は、最近の業績動向及び下期の事業環境等を踏まえ、2027年３月期の通期連結業績予想及び配当予想を見直しました。詳細につきましては、2026年11月10日公表の「通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

引き続き業績動向を精査し、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

（単位：千円）

	前連結会計年度 （2026年３月31日）	当中間連結会計期間 （2026年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,989,005	8,413,414
電子記録債権	85,302	42,541
売掛金	8,346,562	19,415,383
商品	4,985,284	9,914,880
前渡金	1,294,602	5,497,154
その他	158,891	378,196
貸倒引当金	△169,505	△404,803
流動資産合計	21,690,143	43,256,767
固定資産		
有形固定資産		
工具、器具及び備品（純額）	8,511	6,272
土地	5,000	5,000
建設仮勘定	79,200	356,400
その他（純額）	4,842	4,582
有形固定資産合計	97,553	372,255
無形固定資産		
ソフトウエア	3,917	3,062
権利金	70,000	70,000
その他	1,311	1,311
無形固定資産合計	75,229	74,373
投資その他の資産		
投資有価証券	35,000	54,800
差入保証金	50,893	48,590
繰延税金資産	181,079	314,884
その他	5,000	5,000
投資その他の資産合計	271,972	423,274
固定資産合計	444,755	869,903
資産合計	22,134,898	44,126,670
負債の部		
流動負債		
買掛金	2,645,874	7,761,586
短期借入金	11,031,720	22,107,675
１年内返済予定の長期借入金	52,184	7,741
未払法人税等	39,436	1,273,011
賞与引当金	83,616	83,680
前受金	123,330	2,409,716
その他	211,121	313,070
流動負債合計	14,187,284	33,956,482
固定負債		
長期借入金	479,640	472,050
その他	797	－
固定負債合計	480,437	472,050
負債合計	14,667,722	34,428,532
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,438,519	1,438,519
資本剰余金	1,418,499	1,418,499
利益剰余金	5,017,584	7,327,661
自己株式	△486,543	△486,543
株主資本合計	7,388,060	9,698,138
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	79,115	－
その他の包括利益累計額合計	79,115	－
純資産合計	7,467,175	9,698,138
負債純資産合計	22,134,898	44,126,670

（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

（中間連結損益計算書）

（単位：千円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
売上高	19,892,072	45,832,347
売上原価	18,353,700	40,634,799
売上総利益	1,538,371	5,197,548
販売費及び一般管理費	1,113,319	1,431,041
営業利益	425,052	3,766,507
営業外収益		
受取利息	25,333	34,521
為替差益	－	152,861
その他	4,014	15,211
営業外収益合計	29,347	202,593
営業外費用		
支払利息	149,885	416,149
債権売却損	15,109	1,499
為替差損	35,202	－
その他	176	94
営業外費用合計	200,373	417,744
経常利益	254,026	3,551,356
特別利益		
関係会社清算益	19,455	－
特別利益合計	19,455	－
税金等調整前中間純利益	273,482	3,551,356
法人税、住民税及び事業税	75,905	1,213,480
法人税等調整額	25,026	△97,389
法人税等合計	100,932	1,116,091
中間純利益	172,549	2,435,264
親会社株主に帰属する中間純利益	172,549	2,435,264

（中間連結包括利益計算書）

（単位：千円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
中間純利益	172,549	2,435,264
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△27,815	△79,115
その他の包括利益合計	△27,815	△79,115
中間包括利益	144,734	2,356,149
（内訳）		
親会社株主に係る中間包括利益	144,734	2,356,149
非支配株主に係る中間包括利益	－	－

（３）中間連結財務諸表に関する注記事項

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。